

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2019-071

**广东惠伦晶体科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年12月19日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2019年12月9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司以部分机器设备开展融资租赁业务的议案》

本次融资租赁业务融资金额不超过人民币10,000万元，期限不超过5年（含5年）。公司将根据实际经营需要签署融资租赁相关合同，最终实际融资额度不超过本次审批的融资总额度，具体内容以实际签署的协议为准。

本议案具体详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司以部分机器设备开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-070）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2019年12月19日